

国産初!

セラミック等の粉体混合材料

セラミック用高精細光造形装置

SZシリーズはセラミックの未来を開く、
3Dプリンターです。

高精細/多数個造形タイプ

SZ-1000



高精細タイプ

SZ-1100



生産性/造形サイズ向上タイプ

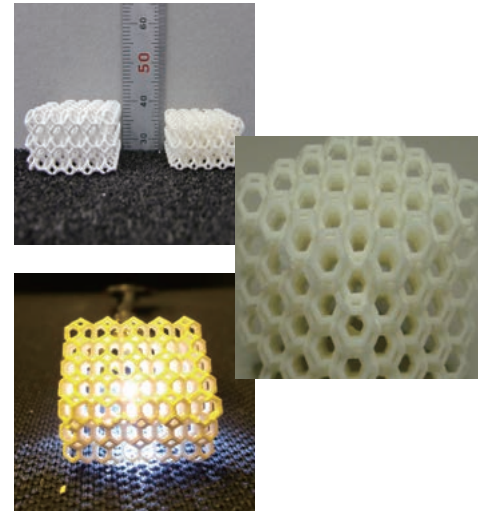
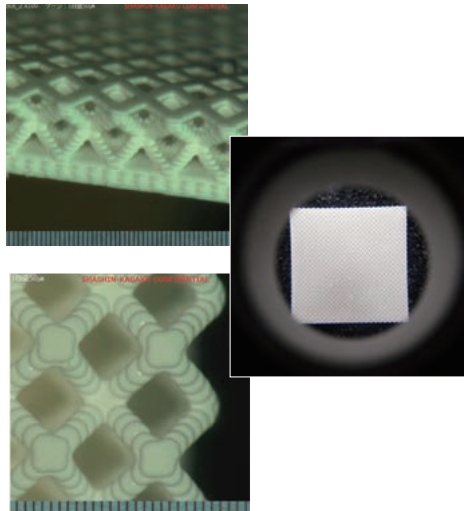
SZ-2500



本 体	装置該寸法(W×D×H)	1800 x 1000 x 1800
	電源	単相AC100V 1.5kVA
	環境	23±2℃ 50%RH以下
光学系	レーザー	クラス4/波長355nm
	出力	250mW
	パワー制御	AOMIによるパワー制御
	偏向装置	デジタル制御方式 ガルバノスキャナー
造 形	造形エリア	縦300mm×横300mm×50mm
	積層ピッチ	5μm~100μm

本 体	装置該寸法(W×D×H)	1100 x 1750 x 1600
	電源	単相AC100V 1.0kVA
	環境	23±2℃ 50%RH以下
光学系	レーザー	クラス4/波長355nm
	出力	250mW
	パワー制御	AOMIによるパワー制御
	偏向装置	デジタル制御方式 ガルバノスキャナー
造 形	造形エリア	縦100mm×横100mm×50mm
	積層ピッチ	10μm~200μm

本 体	装置該寸法(W×D×H)	1600 x 1850 x 1950
	電源	単相AC100V 1.5kVA
	環境	23±2℃ 50%RH以下
光学系	レーザー	クラス4/波長355nm
	出力	1W
	パワー制御	AOMIによるパワー制御
	偏向装置	デジタル制御方式 ガルバノスキャナー
造 形	造形エリア	縦250mm×横250mm×250mm
	積層ピッチ	50μm~200μm



セラミック3D造形

当社SZシリーズによるセラミック造形の工程をご紹介します

1 材料の準備



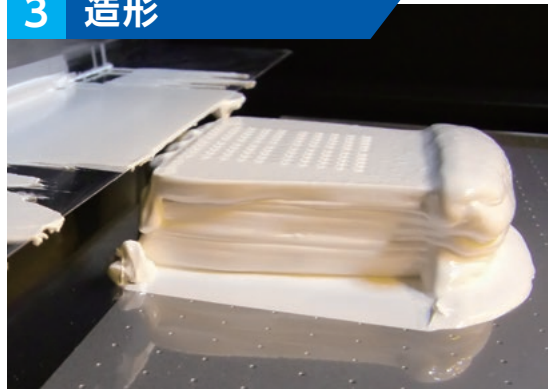
光硬化性樹脂とセラミック粉末を用意します。

2 攪拌・脱泡



材料を攪拌・脱泡し、3D造形に適した状態にします。
多くの場合、粘度が高いスラリー材料になります。

3 造形



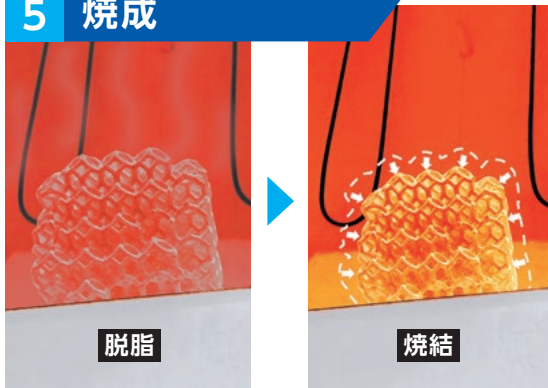
スライスデータに基づいた3D造形を行います。

4 洗浄



造形物を取り出し、未硬化分の材料を洗浄液で洗い流します。

5 焼成



洗浄を終えた造形物は焼結炉にいれ、脱脂・焼結させます。

6 完成



焼結が終われば完成です。